

2020-2025年中国先进封装行业竞争格局分析及投资规划研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2020-2025年中国先进封装行业竞争格局分析及投资规划研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/electric/612361.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 先进封装现状与未来

第一节 封装简介

第二节 封装类型简介

一、SOP封装

二、QFP与LQFP封装

三、FBGA

四、TEBGA

五、FC-BGA

六、WLCSP

七、WLCSP应用

八、Fan-outWLCSP

第二章 全球及中国半导体产业概况

第一节 半导体产业概况

第二节 全球半导体地域分布

第三节 晶圆代工

第四节 中国半导体市场

第五节 中国半导体产业

第三章 封测产业现状与未来

第一节 封测产业现状

第二节 铜打线未来

第三节 封测产业横向对比

第四节 先进封装产业格局

第五节 先进封装市场前景分析

第四章 先进封装下游市场

第一节 手机先进封装市场

第二节 手机基频封装

第三节 手机应用处理器封装

第四节 手机内存封装

第五节 手机收发器封装

第六节 手机PA封装

第七节 手机M与其它零组件

第八节 内存领域先进封装

第九节 CPU、GPU和CHIPSET封装

第十节 CMOS图像传感器封装

第十一节 LCD驱动封测

第五章 先进封装厂家研究

第一节 超丰电子（台湾）

一、企业概况

二、主要产品

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、发展战略

第二节 福懋科技

一、企业概况

二、主要产品

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、发展战略

第三节 力成

一、企业概况

二、主要产品

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、发展战略

第四节 南茂科技

一、企业概况

二、主要产品

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、发展战略

第五节 京元电子

一、企业概况

二、主要产品

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、发展战略

第六节 Amkor

一、企业概况

二、主要产品

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、发展战略

第七节 硅品精密

一、企业概况

二、主要产品

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、发展战略

第八节 星科金朋

一、企业概况

二、主要产品

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、发展战略

第九节 日月光

一、企业概况

二、主要产品

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、发展战略

第十节 景硕

一、企业概况

二、主要产品

三、企业经营状况分析

四、企业主要经营数据指标

五、发展战略

图表目录：：

图表1：各类IC封装图例

图表2：SOP封装产品

图表3：LQFP封装示意图

图表4: FBGA封装示意图

图表5：2015年-2019年全球半导体销售额及增长率 亿美元

图表6：2015-2019年全球十五家晶圆代工厂收入统计与预测

图表7：2015-2019年全球前五家晶圆代工厂收入统计与预测图示

图表8：2019年半导体市场构成图示

图表9：2015-2019中国集成电路产业销售额规模及增长 亿元

图表10：各地区产业现状

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/electric/612361.html>